

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

深圳市英唐智能控制股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 其他（电话交流会） <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	财信证券 汤晶 财信证券 林焕生 东方证券 罗雄 东方证券 林炜 港骏投资 张单单 海通证券 史修奇 龙鳞资管 郭翰 鎏熙资本 刘炯 深圳华银基金 谭鹏飞 深圳共同基金 章景轩 泰禾资本 杨志明 泰禾资本 翟伟兴 文多资产 郑英姿 兴业证券 胡媛媛 语鸿资管 刘念
时间	2021-5-28 15:00-17:30
地点	现场交流会
上市公司接待人员姓名	董事长及总经理：胡庆周 半导体事业群总裁：孙磊 董事会秘书：刘林
投资者关系活动主要内容介绍	<p>（本投资者关系活动记录表中涉及的未来经营计划、预测是公司基于目前的行业、市场环境制定的公司战略发展规划及判断，并不构成业绩承诺，敬请投资者保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。）</p> <p>一、英唐智控转型发展的背景及整合情况介绍</p> <p>胡庆周：首先，欢迎各位投资者朋友到公司调研。英唐智控从2001年创立、2010年创业板上市，到自2019年公司向半导体芯片领域转型发展，算是公司及本人的第三次创业。公司的主营业务是</p>

分销，在 2018 年年底确定未来向半导体芯片领域转型后，在 2019-2020 年用两年时间剥离了数十家不赚钱的或者不符合未来经营战略的子公司。英唐智控的目标是成为以电子元器件渠道分销为基础，半导体设计与制造为核心，集研发、制造及销售为一体的全产业链半导体 IDM 企业集团。从 2019 年开始，在剥离资产的同时，我们也一直做业务转型的整合落地，目前设计端的整合基本完成，包括收购英唐微技术、控股上海芯石，参股了其他半导体公司，也和一些合作伙伴建立了良好关系。现在公司正着手整合制造端，包括对英唐微技术产线升级改造，或者通过收购和自建的方式扩大产能。依托强大的分销渠道，公司从市场需求出发，根据拥有的资源和能力进行产品的设计和制造。在转型的过程中，我认为首先不能给上市公司带来新的负担，其次在投资金额和投资周期上要尽可能节约资金成本和时间成本，从而稳健快速地进行转型落地。接下来有请董秘刘总给大家介绍一下公司转型的情况。

刘林：如大家所知，公司用了两年的时间做业务整合和梳理，剥离了数十家子公司。回顾公司的发展，公司在 2015 年和 2019 年进行了两次战略升级，根据当时的行业和政策环境，公司于 2015 年在分销领域升级，收购了华商龙，经过多年整合发展，公司 2018 年在分销领域成为了 A 股的 NO. 1, 并且在 2018-2020 年保持了前三的地位。随着国内电子产业链上下游企业在全全球贸易保护主义趋势下内销转型及国产替代成为主要趋势，2019 年公司定下向半导体芯片领域转型的战略，于 2020 年完成收购英唐微技术，2021 年完成控股上海芯石，今年筹备在国内建厂。公司敢于向半导体芯片领域转型，一方面是基于公司多年积累的强大分销基础，根据客户的需求、市场渠道向设计、制造延伸。另一方面，基于企业管理系统 UAS 的应用，英唐智控拥有较强的系统级外延并购投后整合能力。

经过两年业务整合，目前英唐智控的业务主要包括半导体研发及制造业务、电子元器件综合解决方案提供业务以及企业管理系统 UAS 业务。目前整体整合进度介绍如下：

人员方面：目前公司员工总数 718 人，其中研发人员 175 人，研发人员约占总人数的 1/4。

知识产权方面：公司拥有专利技术及 IP 共计 378 项，其中境内 329 项，境外专利 49 项。此外，公司与境内外合作伙伴拥有紧密的技术合作关系，通过共同开发、专利互换等方式进一步加强公司的技术储备。

分销业务方面：目前公司电子元器件综合解决方案提供业务主要由华商龙和海威思提供，除巩固和优化原有业务外，公司在分销领域持续开发新的产品线及客户。英唐智控是目前国内市场中产品线种类最丰富的企业之一，合作的品牌超过 200 家，其中国内品牌从 2015 年的不到 10%到现在接近 40%，直接或间接服务的客户基本覆盖国内电子行业的头部企业。

从纵向来看，对比 2019 年、2020 年以及 2021 年一季度数据显示，经过业务整合之后公司盈利能力、营运能力以及偿债能力显著提升，整合效果显著。具体表现为营业利润率：2021 年 Q1 的达到 3.06%，同比上浮 260%，并且也优于 2020 全年的 2.01%，增长势头良好；销售净利率：2021 年 Q1 达到 2.2%，同比上浮 200%；2020 全年为 2.13%，大幅优于去年同期。应收账款周转率：2021Q1 和 2020 全年的应收账款周转率分别为 1.52 和 8.17，相比去年同期分别增长了 11.8%和 41.72%。流动资产周转率：2021Q1 和 2020 全年的流动资产周转率分别为 0.54 和 2.98，相比去年同期分别增长了 16.78%和 11.07%。流动比率：2021Q1 和 2020 全年的流动比率分别为 1.61 和 1.8，相比去年同期分别增长了 39%和 32%；资产负债率：2021Q1 和 2020 全年的资产负债率分别为 61.57%和 58.36%，比去年同期分别下降了 21.12%和 12.13%。

从横向可比上市公司来看，英唐智控 2020 年净资产收益率 16.95%，处于同行第一。存货周转率以及应收账款周转率 2018-2020 年期间均为行业第一，且显著高于平均水平。特别是 2020 年的应收账款周转率，几乎是同业均值的两倍。这主要取决于英唐智控先进

的电子管理系统与成熟的运营经验。

半导体研发及制造业务方面：公司半导体研发及制造业务的业务主体目前主要是上海芯石和英唐微技术，公司目前也在进行持续的产业投入和人才培养，计划通过内外整合、存量产线改造升级、新建及收购迁移产线等方式，打造从材料供应、芯片设计、芯片制造到芯片销售的完整半导体全产业链条。

英唐微技术目前的整合效果及未来规划如下：

2020年4月-2020年10月期间，英唐微技术并表前7个月内，营业收入为1.77亿元人民币，净亏损500万。2020年11月-2021年3月期间，英唐微技术并表后的5个月内，实现营业收入1.67亿元人民币，净利润1,100万，远超并表前7个月净利润总和。2021年一季度，英唐微技术实现营业收入10,483.58万元，较上年同期增长23.64%，占公司当期营业收入的6.74%；实现净利润1,671.27万元，较上年同期增长459.06%。

公司对英唐微技术的整合主要是基于其历史悠久、研发团队以及拥有一条完整的6英寸晶圆生产线月产能5000片晶圆的优势。英唐微技术位于日本国山梨县首府甲府市，甲府市是日本半导体产业的聚集地，这也为公司后续发掘更好的半导体工厂、技术人员、研发团队提供了非常便利的条件。

上海芯石是一家功率器件的研发、设计与销售企业，在半导体功率器件芯片领域具有十几年的技术储备及行业经验。公司对上海芯石的整合主要是基于其研发团队、专利技术、以及产品线丰富的优势进行整合。目前对上海芯石的主要产品规划划分为三大类，后续半导体事业部的孙总将为大家详细介绍。

公司UAS系统对上述业务整合的有效实施起到了重要的作用。企业管理系统UAS，主要包括ERP联合应用系统，MES智能制造执行系统、WMS智能仓储管理系统。该系统由公司旗下企业管理系统开发企业优软科技为公司业务体系量身定制，整合了供应链管理、风控管理、研发制造管理等，拥有系统级的对被并购标的的高效的整合

能力。对于新并购的企业，公司都将并购企业的业务融入到系统中，用公司统一的系统平台来实现供应链管理、企业管理、风控管理和研发制造管理。除了英唐智控全集团在使用 UAS 管理系统进行统一管理、统一资金调配之外，该系统还有上百家公司在用，主要是电子制造行业以及半导体公司。

关于公司半导体研发、制造业务整合的具体情况，请公司半导体事业群总裁孙总为大家做介绍。

孙磊：大家好。自 2020 年 10 月份公司完成收购英唐微技术以来，我们根据半导体产业特点和公司战略规划设计和搭建了业务架构，目前半导体事业群直属于总裁办，下设销售部、市场部、研发部、方案应用部以及英唐微技术和上海芯石两大业务主体。公司半导体事业群和分销事业群是相对独立的，各自遵守与客户的商业保密原则。

英唐微技术成立于 2003 年，是在全球光电集成电路领域排名及日本车载数字信号芯片领域排名领先的，集设计研发、制造为一体的日本 IDM 半导体公司。

英唐微技术的主要产品是以光电技术为基础的，包括 Photo IC for ODD、Digital IC for automotive、Driver IC for display、Analog IC for automotive、Photo IC for sensor、Optical scanner IC 等，主要应用于包括光驱、多媒体设备、车载数字电视、投影仪、车用电压检测、车载显示、卫星导航、打印机、产线自动导引车、HUD 等领域或产品。未来重点开发及推广的产品主要是车载 IC、传感器以及 MEMS 振镜，应用领域为车用天线、导航仪器、工业、消费电子、健康、医学、车用雷达等。

除产品开发外，英唐微技术也在扩展国内产品及代工市场，目前已有部分产品处于研发评估及样品测试阶段。

上海芯石是一家功率器件的研发、设计与销售企业，在半导体功率器件芯片领域具有十几年的技术储备及行业经验，拥有资深的研发团队及技术顾问团队。公司通过整合上海芯石的核心技术优势

以及公司强大的分销能力、分销渠道，加快在功率器件领域的布局。目前上海芯石的产品布局如下，一类为成熟产品可批量销售的，主要包括 Si 基的 SBD、FRED、MOSFET、ESD、TVS 产品，SiC 基的 SBD 产品；一类为重点开发产品，主要包括 IGBT、SiC 基的 MOSFET 产品等；一类为目标开发产品，主要包括 Si 基的 PMIC(电源管理芯片)、GaN 基的 HEMT、FET、Power IC。各类产品研发、制造、销售依据计划表有序进行。

除根据英唐微技术、上海芯石拥有的优势资源进行产品规划外，公司还根据整体战略规划未来重点布局的产品，例如通用 MCU 运算单元、电源管理芯片以及 IPM/BLDC。

在对产线的未来规划上，为实现成为集研发、制造及销售为一体的全产业链半导体 IDM 企业集团的战略目标，公司计划通过改造+收购+新建的方式扩大产能。除了在国内建设新产线之外，公司还计划将目前英唐微技术拥有的 6 英寸硅基生产线部分改造为第三代半导体测试、生产线。未来，公司也有可能收购国外完整的硅基、碳化硅生产线并迁移回国内。

以上为本次公司半导体业务的介绍，谢谢大家。

二、投资者问答交流环节

问题一：请问今后对英唐微技术在新产品开发上有哪些规划？

回答：未来几年内，英唐微技术将在原来研发储备的基础之上，重点开发和推广以下几类产品：

车载 IC 类，主要包括 Antenna Diagnostic、ALS、OFDM、Noise Cancellation，主要应用于车用天线、导航仪器、5G、WiFi6+等领域；

传感器，主要包括各类的光电传感器，在工业、消费电子、健康和医学领域被广泛应用；

MEMS 振镜，主要应用于车用激光雷达。

问题二：公司很大的一块业务是分销，分销的毛利率比较低，

请问公司有哪些改善措施或者战略部署？

回答：公司整个集团使用 UAS 系统，我们在系统中设置资金占用率、毛利率、存货等关键指标，实时监测分销业务的变化情况，对于资金占用高，毛利率较低的业务，我们会查找原因并逐步优化，而对于资金占用低、毛利率较高的产品，我们会加大投入。通过对产品线的逐步优化，提升分销业务的盈利能力。

2020 年度，受国内外疫情暴发以及持续的中美贸易摩擦影响，公司下游客户需求放缓，再加上公司持续优化产业结构，电子分销业务剥离了怡海能达、英唐创泰、联合创泰等电子分销主体，因此公司 2020 年度电子分销营业收入受到一定影响。但剥离上述分销主体的同时，公司也剥离了一些不良资产、商誉，这为公司后续转型打下了良好的基础。

问题三：去年公司扣非后亏的比较多，请问具体原因是什么？

回答：一方面，2020 年受疫情影响，公司整体营收规模有所下滑；另一方面，受市场变化及公司优化产业结构调整战略目标的影响，信用减值损失及资产减值损失增加，以及公司搬迁新办公地址原办公楼装修费一次摊销完毕等因素影响。

问题四：以后分销业务将如何开展？

回答：公司自 2019 年确立向半导体芯片领域转型升级的战略布局以来，对分销业务体系进行了一系列的优化整合，先后剥离了怡海能达、联合创泰等一批分销业务主体，分销业务的专业化、集聚化程度得以加强，毛利率得以提升。在此基础上，公司将做好分销业务的稳步发展，不盲目的追求分销业务规模的扩张，而是将现有分销业务做深做强，加强同上游原厂的技术及 IP 合作，加强对现有客户的服务能力。从而为公司半导体研发制造业务的顺利开展创造有利条件。

问题五：今年一季度半导体业务净利润多少，预计今年全年可实现净利润多少？

回答：2021 年一季度，英唐微技术实现营业收入 10,483.58 万

	<p>元，较上年同期增长 23.64%，占公司当期营业收入的 6.74%；实现净利润 1,671.27 万元，较上年同期增长 459.06%。占公司当期净利润的 48.78%。目前公司整合工作有序进行，预计 2021 年公司半导体业务净利润将会有逐步体现。具体的盈利情况请您继续关注公司定期报告披露的相关数据。</p> <p>问题六：公司筹备建厂资金需求较大，后续是否会通过定增等方式进行再融资？公司如何解决转型中资金需求问题？</p> <p>回答：2020 年剥离了联合创泰等一系列资产后回笼了现金，公司目前不存在资金短缺的问题。</p> <p>英唐智控作为上市公司，不排除公司后续将以定增的方式融资获得向半导体芯片领域转型所需要的资金支持。也不排除以合作的方式与其他投资者在半导体领域开展业务合作。</p> <p>问题七：公司计划和地方政府开展合作，请问目前谈的怎么样了，确定好哪一家政府了吗？</p> <p>回答：目前公司已基本确定了有合作意向的几家政府，目前公司在加速推进评估和商谈具体合作细节。</p> <p>接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 5 月 31 日